

品名：TSSOP56-DIP56 轉接板 0.635mm/0.8mm 間距 SDRAM 轉接板】



板材：KB 的軍工 A 級料，FR4。

鍍錫：無鉛環保/RoHS

功能：

1.正面：

引腳間距 **0.8mm**，適用於將常用 TSSOPII 56 等封裝轉成直插，常用於 SDRAM 類晶片的轉接。

2.反面：

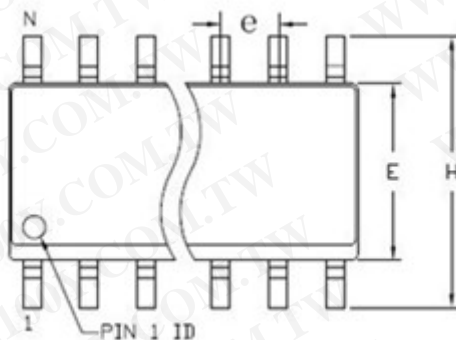
引腳間距 **0.635mm**，適用於將常用 TSOPII 56 等封裝轉成直插。

3.外擴

外擴 DIP 孔間距 2.54mm，可直接插在 2.54 間距的萬用板或其它實驗板上。

尺寸確認小貼士：（僅供參考）

在確認 pin 數夠用時，快速確認只需核對如下圖所示中的三個尺寸：引腳間距 **e** 及晶片和焊盤寬度 **E** 和 **H**



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)